



明新科技大學111學年度教師產業研習

半導體封裝製程與設備實務培訓營招生簡章

主辦單位	明新科技大學				
課程時間/ 課程名稱/ 師資	第一梯次(10天，共70小時)				
	日期	時間	培訓內容	講員	服務機構及職稱
	1/30 (一)	08:30-12:00	半導體構裝技術的演變	蔡天寶	力成科技股份有限公司封裝製造暨設備整合處處長
		13:00-16:30	晶圓切割機系統概要及參數設置	何信松	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	1/31 (二)	08:30-12:00	IC 產業發展	呂明峯	明新科技大學電子工程系教授兼半導體學院院長
		13:00-16:30	刀具拆裝操作及檢測機制調整	何信松	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	2/1 (三)	08:30-12:00	半導體製程技術	陳炳茂	明新科技大學半導體與光電科技系副教授兼系所主任
		13:00-16:30	切割成品的前置作業設定	何信松	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	2/2 (四)	08:30-12:00	半導體製程技術	陳炳茂	明新科技大學半導體與光電科技系副教授兼系所主任
		13:00-16:30	晶圓切割機台實機操作	何信松	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	2/3 (五)	08:30-12:00	半導體製程技術	陳炳茂	明新科技大學半導體與光電科技系副教授兼系所主任
		13:00-16:30	黏晶機系統概要及參數設置	林賢昇	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	2/6 (一)	08:30-12:00	半導體封裝第一階層連接方法	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體學院副院長
		13:00-16:30	彈匣及軌道傳送定位及校正	林賢昇	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	2/7 (二)	08:30-12:00	傳統半導體封裝製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體學院副院長
		13:00-16:30	黏晶的前置作業設定	林賢昇	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	2/8 (三)	08:30-12:00	信號重置製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體學院副院長
		13:00-16:30	黏晶機台實機操作	林賢昇	力成科技股份有限公司資深設備工程師



2/9 (四)	08:30-12:00	進階封裝製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體學院副院長
	13:00-16:30	QFN 機台功能介紹	鄭國偉	廣化科技股份有限公司業務處經理
2/10 (五)	08:30-12:00	先進封裝製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體學院副院長
	13:00-16:30	如何解讀 QFN 製程程式	陳慶恩	廣化科技股份有限公司關鍵技術研發處資深研發工程師

第二梯次(10 天，共 70 小時)

日期	時間	培訓內容	講員	服務機構
7/3 (一)	08:30-12:00	IC 產業的市場需求與挑戰	呂明峯	明新科技大學電子工程系教授兼半導體學院院長
	13:00-16:30	QFN 操作參數的檢測	陳慶源	廣化科技股份有限公司生產處資深工程師
7/4 (二)	08:30-12:00	晶圓級封裝製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體學院副院長
	13:00-16:30	QFN 機台實機操作	陳慶源	廣化科技股份有限公司生產處資深工程師
7/5 (三)	08:30-12:00	面板級封裝製程	趙守嚴	明新科技大學電子工程系副教授兼半導體學院副院長
	13:00-16:30	打線機系統概要及參數設置	黃志賢	力成科技股份有限公司資深設備工程師
7/6 (四)	08:30-12:00	先進封裝的發展	張香鈺	工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組經理
	13:00-16:30	瓷嘴更換及調整	黃志賢	力成科技股份有限公司資深設備工程師
7/7 (五)	08:30-12:00	先進封裝的未來挑戰	張香鈺	工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組經理
	13:00-16:30	打線機彈匣及軌道定位調整	黃志賢	力成科技股份有限公司資深設備工程師
7/10 (一)	08:30-12:00	先進封裝製程實務	張香鈺	工研院電子與光電系統所異質整合智能系統組經理
	13:00-16:30	打線機實機操作	黃志賢	力成科技股份有限公司資深設備工程師
7/11 (二)	08:30-12:00	晶圓切割機操作能力檢測	何信松	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	13:00-16:30			



	7/12 (三)	08:30-12:00 13:00-16:30	固晶機操作能力檢測	林賢昇	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	7/13 (四)	08:30-12:00 13:00-16:30	打線機操作能力檢測	黃志賢	力成科技股份有限公司資深設備工程師
	7/14 (五)	08:30-12:00	半導體封裝製程學習評量	呂明峯	明新科技大學電子工程系教授兼半導體學院院長
		13:00-16:30	半導體封裝機台實務操作評量	蔡天寶	力成科技股份有限公司封裝製造暨設備整合處處長
開課日期	第一梯次： 2023/01/30(一)至 2023/02/10(五)，每周一至周五(共 10 天)，早上 8:30 至下午 16:30。 第二梯次： 2023/07/03(一)至 2023/07/14(五)，每周一至周五(共 10 天)，早上 8:30 至下午 16:30。				
開課地點	明新科技大學逢喜樓 209 教室 明新科技大學半導體封裝測試類產線基地				
參與對象	高中職及大專院校教師。				
收費標準	免費				
招生人數	招生人數 30 人(校外 10 人、校內 20 人)				
報名網址	https://forms.gle/4hipgy9nkyBj5VYs5				
開班人數	最低開課人數 30 人				
結訓要求	缺席率達 30%以上(含)，不頒發結業證書。				